

Microchip 社、過酷な環境での要求の厳しいアプリケーション向けに設計された 新型 BZPACK mSiC[®] パワーモジュールを発表

BZPACK mSiC パワーモジュールは、Microchip の mSiC 技術を採用し、MB および MC SiC MOSFET ファミリの高い性能を活かした製品です

2026 年 3 月 23 日[NASDAQ:MCHP] – Microchip Technology Incorporated(日本法人:東京都港区浜松町、代表: 櫻晴彦 以下 Microchip 社)は本日、HV-H3TRB(高電圧、高温、高温逆バイアス)の厳しい基準を満たすように設計された [BZPACK mSiC[®] パワーモジュール](#) を発表しました。BZPACK モジュールは、要求の厳しい電力変換用途においてきわめて高い信頼性を実現し、製造を効率化すると共に、柔軟なシステム設計を可能にします。ハーフブリッジ、フルブリッジ、三相、PIM/CIB 構成を含む幅広いトポロジで利用可能で、設計者は性能、コスト、システムアーキテクチャを柔軟に最適化することができます。

BZPACK mSiC パワーモジュールは 1,000 時間の基準を超える HV-H3TRB 規格に適合する事が試験で実証済みのため、産業用および再生可能エネルギーアプリケーションに安心して導入できます。CTI(比較トラッキング指数)600V 対応のケース、全温度レンジで安定した $R_{ds(on)}$ 、酸化アルミニウム(Al_2O_3)または窒化アルミニウム(AlN)の基板オプションにより、優れた絶縁性、温度管理、長期耐久性を発揮します。

Microchip 社 high-power solutions business unit 担当副社長の Clayton Pillion は次のように述べています。「今回の BZPACK mSiC パワーモジュールの発表は、きわめて要求の厳しい電力変換用途向けに耐久性と性能に優れたソリューションを提供していくという Microchip 社の確固たる姿勢を裏付けるものです。Microchip 社の高度な mSiC 技術を活用する事で、産業用市場とサステナビリティ市場全体にわたって、効率的で長寿命なシステムをより簡単に構築できるようになります」

BZPACK モジュールは、生産効率化とシステムのシンプル化のため、はんだ付けが不要なプレスフィット端子とコンパクトなベースプレートレス設計を特長としています。オプションでTIM(熱伝導材料)塗布済みのモジュールも選択可能です。このような多彩なオプションにより、組み立て時間が短縮されると共に、製造の一貫性も向上します。また、業界標準フットプリントでマルチソース化も容易になります。さらに、利便性を高めるため、各モジュールはピン互換で設計されています。

Microchip 社の mSiC MOSFET の MB および MC ファミリは、AEC-Q101 規格に準拠したオプションが用意されており、産業用および車載用アプリケーションに堅牢なソリューションを提供します。これらのデバイスは一般的なゲートソース間電圧($V_{GS} \geq 15V$)に対応しており、組み込みを容易にするために業界標準のパッケージで提供されます。HV-H3TRB で実証済みの性能により、湿気によるリーク電流や絶縁破壊によってフィールドで障害が発生するリスクを抑え、長期信頼性を確保できます。MC ファミリはゲート抵抗を内蔵しており、スイッチング制御の向上、低いスイッチングエネルギーの維持、マルチダイ モジュール構成における安定性の向上を実現します。現在、TO-247-4 ノッチとダイ形式(ワッフルパック)のオプションを提供しています。

Microchip 社、過酷な環境での要求の厳しいアプリケーション向けに設計された新型 BZPACK mSiC®パワーモジュールを発表

2-2-2-2

Microchip 社は 20 年以上にわたる SiC デバイスと電源ソリューションの開発、設計、製造、サポート経験を活かし、お客様が SiC を簡単迅速、かつ自信を持って導入できるようお手伝いします。Microchip 社の mSiC 製品およびソリューションは、システムコストを削減し、開発期間を短縮し、リスクを低減できるように設計されています。また、SiC ダイオード、MOSFET、ゲートドライバの広範かつ柔軟なポートフォリオを提供しています。詳細は www.microchip.com/sic を参照してください。

価格と在庫/供給状況

BZPACK mSiC パワーモジュールは本日より量産受注を開始いたします。ご購入は Microchip 社の [正規代理店](#) にお問い合わせ頂くか、Microchip 社の [オンラインストア](#) をご利用ください。

リソース

高画質の写真は報道関係専用窓口までお問い合わせ頂くか、Flickr でご覧ください。掲載に許可は不要です。

- アプリケーション画像: www.flickr.com/photos/microchiptechnology/55114468015/sizes/l

Microchip Technology 社について:

Microchip 社は、幅広い半導体製品を提供する半導体サプライヤであり、新しい技術を市場投入する際の重要な課題を解決するトータルシステムソリューションを通じて、革新的な設計をより簡単に実現する事に尽力しています。使いやすい開発ツールと包括的な製品ポートフォリオにより、コンセプトの創出から完成までの設計プロセス全体にわたってお客様をサポートします。Microchip 社は本社をアリゾナ州チャンドラーに構え、産業、車載、民生、航空宇宙と防衛、通信、コンピューティングの市場で優れた技術サポートとソリューションを提供しています。詳細は Microchip 社ウェブサイト(www.microchip.com) をご覧ください。

###

Note: Microchip 社の名称とロゴ、Microchip ロゴは米国およびその他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です。mSiC は米国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です。その他の商標は各社に帰属します。

詳細については、以下にお問い合わせください。

Helen Tang (Microchip 社):

(メール: Helen.Tang@microchip.com)

松田、仙場 (共同 PR):

(メール: mchp-pr@kyodo-pr.co.jp)

報道関係者の方へ: このニュースリリースのメールによる配信については、共同 PR 株式会社 松田もしくは仙場まで電話(03) 6260 4863 またはメール mchp-pr@kyodo-pr.co.jp でお問い合わせください。